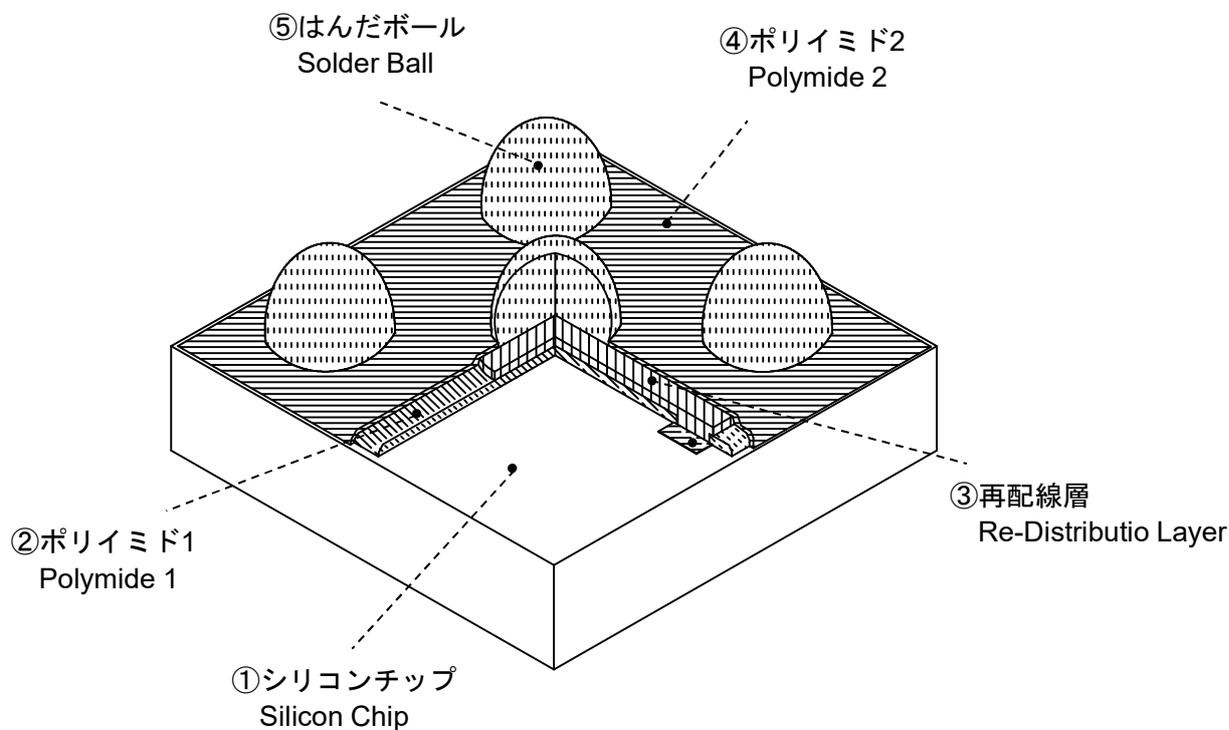


## WLP-5-03 構造図

## WLP-5-03 Perspective

RoHS 対応品  
RoHS Compliance



項目 Item	材料 Material	備考 Note
① シリコンチップ Silicon Chip	シリコン Silicon	
② ポリイミド1 Polyimide 1	ポリイミド Polyimide	
③ 再配線層 Re-Distribution Layer	ニッケル + 銅 + チタン Nickel + Copper + Titanium	
④ ポリイミド2 Polyimide 2	ポリイミド Polyimide	
⑤ はんだボール Solder Ball	スズ + 銀 + 銅 Tin + Silver + Copper	

捺印表示 Marking	レーザー Laser marking
-----------------	-----------------------